

Proces obróbki płyt

TOYOBO

Printight®

INFO
GRA
FIKA

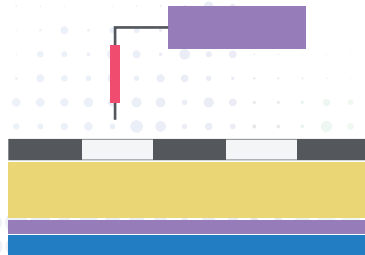
1A Kontakt z negatywem



Zdjęcie folii ochronnej oraz położenie negatywu stroną emulsji na płytę.

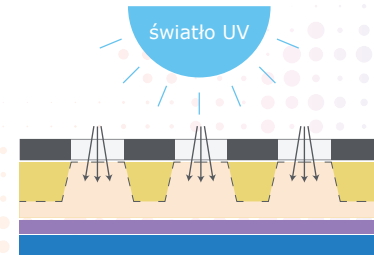
LUB

1B Ablacja, laser CtP



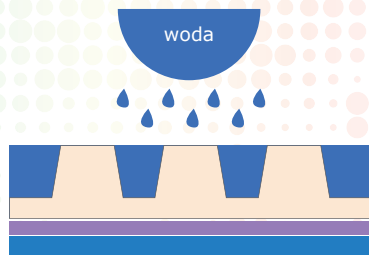
Ablacja płyty na laserze CtP.

2 Naświetlanie powierzchni



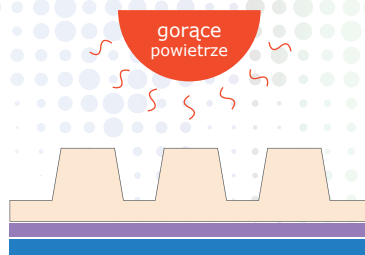
Naświetlanie płyty przez negatyw lub poprzez czarną maskę.

3 Wymywanie



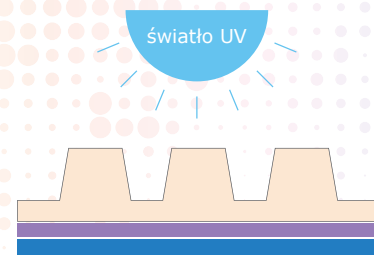
Wymywanie w wodzie. Czas wymywania zależy od grubości płyty.

4 Suszenie



Suszenie płyty gorącym powietrzem, poprzedzone usunięciem z powierzchni płyty pozostałości wody przy użyciu pistoletu ze sprężonym powietrzem. Czas suszenia zależy od typu płyty.

5 Doświetlanie UVA



Doświetlanie płyty promieniami UVA. Doświetlanie powinno trwać tak samo lub dłużej niż naświetlanie główne.

print
systems

yes,
we
care!